

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分
 【発行日】平成 18 年 12 月 21 日 (2006.12.21)

【公開番号】特開 2004-207690 (P2004-207690A)
 【公開日】平成 16 年 7 月 22 日 (2004.7.22)
 【年通号数】公開・登録公報 2004-028
 【出願番号】特願 2003-377024 (P2003-377024)
 【国際特許分類】

H 0 5 K 7/20 (2006.01)

F 2 8 F 3/04 (2006.01)

H 0 1 L 23/373 (2006.01)

【F I】

H 0 5 K 7/20 B

F 2 8 F 3/04 Z

H 0 1 L 23/36 M

【手続補正書】
 【提出日】平成 18 年 11 月 1 日 (2006.11.1)
 【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0 0 0 3
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【0 0 0 3】

ところで、近年、前記コンピュータ等の電子機器では、よりコンパクトで軽量の製品が好まれる傾向にあり、そのためにはヒートシンクやヒートシンクを使用した熱交換器の小型化や軽量化が重要な課題となり、しかも小型で軽量であっても高い熱交換性能を持つものが要求されるようになった。

【特許文献 1】特開 2 0 0 2 - 1 5 1 1 号公報
 【特許文献 2】特開 2 0 0 2 - 6 4 1 7 0 号公報
 【特許文献 3】特開 2 0 0 2 - 1 9 0 5 5 8 号公報
 【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0 0 3 3
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【0 0 3 3】

【表 2】

樹脂名	記号	グレード	荷重たわみ温度		連続使用温度 (電氣的)	融点
			0.45MPa °C	1.82MPa °C		
モノマーキヤストナイロン	PA	耐熱性	>215	>200	150	200
ポリアミドイミド	PAI	N	—	278	250	—
		ガラス充填	—	271	260	—
		摺動性	—	278	250	—
ポリベンズイミダゾール	PBI	N	—	435	345	—
ポリエーテルエーテルケトン	PEEK	N	—	155	250	340
		GF30%	—	230	250	334
		摺動性	—	195	250	340
		導電性	—	230	250	340
ポリエーテルイミド	PEI	N	210	200	170	—
ポリエーテルサルホン	PES	GF30%	212	210	170	—
		N	210	203	180	—
		GF30%	—	216	180	—
ポリイミド	PI	N	—	360	304	—
ポリフェニレンサルファイド	PPS	N	—	121	220	282
		GF40%	—	260	220	278
		GF30%	190	185	160	—
ポリサルフォン	PSU	GF30%	121	55	260	327
ポリテトラフルオロエチレン	PTFE		74	47	260	310
テトラフルオロエチレン-ハーフフルオロアルコキシアルカン	PFA		72	50	200	275
フルオロエチレン-プロピレン	FEP		126	—	177~220	220
ポリクロロトリフルオロエチレン	PCTFE		104	74	150~180	270
テトラフルオロエチレン-エチレン	ETFE		116	77	165~180	220~245
エチレンクロロトリフルオロエチレン	ECTFE					